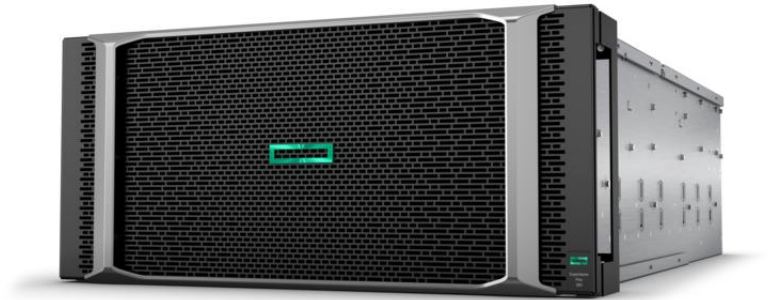


HPE SUPERDOME FLEX 280 伺服器

Superdome Flex 伺服器



新增功能

- 提供更多的處理器和 I/O 選項。
- 支援適用於 HPE 產品的 Intel® Optane™ 持續性記憶體 200 系列
- 支援 NVMe 磁碟機/三模控制器。
- 支援 6 插槽組態。

概觀

您是否正在為企業環境中最嚴苛的工作負載尋求所需的效能、可靠性和安全性？HPE Superdome Flex 280 是一款具有高可靠性的伺服器，可從搭載 2 個第 3 代 Intel® Xeon® 可擴充處理器開始起步，然後視需要擴充至最多 8 個。模組化架構可讓您經濟高效地擴充，以因應未來成長之需。每個處理器都具有 6 個 UPI 連結，可提供比前幾代處理器更高的頻寬和更快的資料速率。[1] 經過精心設計，可透過使用 DRAM 或混搭使用 DRAM 與持續性記憶體提供 64 GB 到 24 TB 的共用記憶體，是即時分析的理想之選。卓絕的 HPE Superdome RAS 具備先進的記憶體復原力、「韌體優先」(Firmware First) 技術、分析引擎，以及自

我修復等多項功能，可大幅延長系統運作時間。包括矽晶片信任根 (Silicon Root of Trust) 支援在內的卓越安全性，可妥善保護您的關鍵工作負載。HPE GreenLake 的即服務消費模式提供十足彈性，同時保有內部部署的控制力。

功能

利用無與倫比的彈性，滿足不斷演進的業務需求

HPE Superdome Flex 280 伺服器採用模組化 5U 2 或 4 插槽建置區塊，可讓您經濟高效地從 2 個插槽擴充至 8 個插槽，以因應未來成長之需。

靈活選擇經濟型黃金級或高端白金級第 3 代 Intel Xeon 可擴充處理器，在單一系統中提供 16 至 224 個強大的運算核心。

HPE GreenLake 的服務型選項提供消費彈性，同時保有內部部署的控制力。

利用包含了 HPE OneView 管理、OpenStack、Redfish API 和易於使用的管理 GUI 在內的全方位架構，大幅簡化管理作業。

利用提高的效能，滿求要求最嚴苛的工作負載

HPE Superdome Flex 280 伺服器模組化架構在每個處理器提供 6 個 UPI 連結，並提供比前幾代更高的頻寬和更快的資料速率。[1]

HPE Superdome Flex 280 伺服器經過精心設計，可僅使用 DRAM 或混搭使用 DRAM 與適用於 HPE 產品的 Intel Optane 持續性記憶體 200 系列，提供 64 GB 到 24 TB 的共用記憶體，非常適合用於記憶體內部分析。

利用支援最多 32 張 PCIe 3.0 配接卡的平衡 I/O 系統，解決資料量龐大和網路連線能力的問題，亦可選擇 16 插槽 (皆為薄型) 或 12 插槽 (全高/全寬)。此伺服器支援多達 20 個 SAS/SATA/NVMe 磁碟機，並提供 RAID 和硬體加密，還可選購 DVD 光碟機。

利用優異的可靠性與卓越的安全性，保護關鍵工作負載

HPE Superdome Flex 280 伺服器具備一套全方位的 RAS 功能，可為關鍵業務應用程式提供最高服務層級。

利用慧與的「Firmware First」(韌體優先) 方法，在作業系統層發生任何中斷之前，提早抑制韌體層級上的錯誤 (包括記憶體錯誤)。

利用備受肯定的故障處理分析引擎，預測硬體故障並在沒有操作人員的協助下啟動自我修復，進而降低人為錯誤。

利用卓越的安全性功能 (包括矽晶片信任根 (Silicon Root of Trust))，減少暴露於威脅的風險，並幫助您的裝置抵禦韌體攻擊和惡意軟體。

利用 HPE Serviceguard for Linux (SGLX) 高可用性和災難復原叢集解決方案，為 Linux® 工作負載提供業務永續性。此解決方案可以跨越任何距離的實體或虛擬環境，防止發生大規模的基礎架構和應用程式故障。



技術規格

HPE Superdome Flex 280 伺服器

處理器類型	Intel®
處理器名稱	Intel Xeon 可擴充處理器 (白金級或黃金級)
處理器系列	每個機箱 4 個 Intel® Xeon® 可擴充處理器 (白金級或黃金級)
可用處理器核心	28 或 24 或 20 或 18 或 16 或 8
處理器快取記憶體	16.5 MB 或 22 MB 或 24.75 MB 或 27.5 MB 或 33 MB 或 35.75 MB 或 38.5 MB
處理器速度	3.9 GHz，最高頻率視處理器而定
磁碟機類型	多達 20 個 2.5 英吋 SFF SAS/SATA 固態硬碟或 SATA HDD。每個機箱 10 個
磁碟機說明	0 至 20
網路控制器	每個基本型機箱板載 2 個 1 GbE 連接埠。可透過 I/O 卡取得額外的網路連線。
最大記憶體	經過精心設計，可在 8 插槽系統中配備高達 24 TB 記憶體
記憶體類型	DDR4 記憶體，可選購持續性記憶體
記憶體插槽	每機箱 48 個 DIMM 插槽
擴充插槽	每個機箱多達 16 個；如需詳細說明，請參閱規格速覽。選購配件包括具有全高功能的 12 插槽；16 插槽；0 插槽位 - 僅運算
電源供應器種類	HPE 1600W 熱抽換電源供應器。可選購 2130W 熱抽換電源供應器。每個機箱最多 4 個
基礎架構管理	Web 型 GUI、命令列和 Redfish
系統風扇功能	熱插拔
機型	機箱為 5U 機櫃
光碟機類型	DVD-RW 或 DVD-R
產品尺寸 (公制)	21.82 x 44.45 x 87.95 公分 (機箱)，寬度不含安裝滑軌，深度為握把到握把的測量值
重量	平均 50 公斤
保固	3 年零件、3 年人工、3 年到府支援服務。如需瞭解有關保固的詳細資訊，請參閱： https://h20564.www2.hpe.com/hpsc/wc/public/home 。適用於您產品的其他 HPE 支援和服務均可在當地購買。有關服務升級的可用性及其這些服務升級成本的相關資訊，請參閱 HPE 網站： http://hpe.com/support 。



如需進一步瞭解技術資訊、
可用的機型與選項，請參考
[規格速覽](#)

HPE POINTNEXT SERVICES

[HPE Pointnext Services](#) 將技術與專業知識緊密結合，協助您推動業務成長並為未來做好準備。

HPE Pointnext Services 的營運服務

[HPE Pointnext Tech Care](#) 可讓您快速接洽特定產品專家並感受 AI 導向的數位經驗，同時也能提供一般技術指導，協助您不斷創新。我們徹底重塑 IT 支援的精神，可以加速解決問題並發揮更大的價值。HPE Pointnext Tech Care 不同於「修修補補」的做法，致力於不斷追求更好的做事方式，協助您專心達成業務目標。

[HPE Pointnext Complete Care](#) 是一項模組式的邊緣到雲端 IT 環境服務，提供全方位的方法，能將整個 IT 環境調整到最好，也能提供以客戶為中心的專屬服務，實現符合預期的 IT 成果和業務目標。這一切全都本公司 HPE Pointnext Services 專家團隊的掌握之中。

[HPE 整合與效能服務](#) 依據個別需求、工作負載和技術提供豐富的服務，能協助您按照產品生命週期當中的任何一個階段規劃貼近需求的服務。

- 建議、設計與轉型
- 部署
- 整合與移轉
- 運作與改善
- 租賃服務
- Greenlake 管理服務
- 淘汰與淨化
- IT 訓練和個人發展

其他相關服務

[HPE Education Services](#) 提供全方位的服務，能夠支援員工在數位轉型歷程中擴充必要技能。如有任何疑問或想深入瞭解支援選項，請向慧與銷售代表或授權通路合作夥伴洽詢。

[保留瑕疵媒體](#) 是選購的服務，您可以透過這項服務保留因故障而由慧與替換的磁碟或符合條件的固態硬碟/快閃磁碟機。

HPE GREENLAKE

[HPE GreenLake](#) 是慧與引領市場的 IT 即服務產品，這項產品運用統一的運作模式，將雲端經驗延伸到位於各處（資料中心、多雲端和邊緣）的應用程式和資料。HPE GreenLake 是內部部署工作負載所需的公用雲端服務和基礎架構，是採用依使用付費模式的全代管服務。

如果您想瞭解 [IT 租賃解決方案](#) 等其他服務，請按[一下這裡認識相關產品](#)。

做出正確的採購決策。
請與我們的售前專家聯繫。

[請來電洽詢是否提供](#)



立即交談



立即致電



立即購買



立即分享



獲取最新資訊

[1] 第 3 代 Intel Xeon 可擴充處理器架構具有 6 個 UPI 連結，是第 2 代 Intel Xeon 可擴充處理器架構的兩倍。最高資料速率為 3200 MT/秒（以 1 DPC 方式配置時），比第 2 代 Intel Xeon 可擴充處理器高出 9%。

© Copyright 2021 Hewlett Packard Enterprise Development LP. 本文件所含資訊如有變更，恕不另行通知。慧與產品與服務的唯一保固已詳細記載於此類產品與服務隨附的明示保固聲明中。不應將本文件任何資訊視為構成額外的保固。慧與對於本文件中的技術、編輯錯誤或遺漏概不負責。

零件和材料：為了維護服務範圍內的硬體，慧與將提供由慧與提供支援的必要更換零件和材料。

若零件和元件達到製造商操作手冊、產品規格概要或技術產品資料表中所載之最長支援使用期限及/或最大使用限制，則此服務將不包含提供、維修或更換該零件和元件。

Intel Xeon 和 Intel Optane 是 Intel Corporation 或其子公司在美國和/或其他國家/地區的商標。Linux 是 Linus Torvalds 在美國和其他國家/地區的註冊商標。SAP HANA 是 SAP SE (或 SAP 附屬公司) 在德國和其他國家/地區的商標或註冊商標。Oracle 是 Oracle 和/或其附屬公司的註冊商標。所有協力廠商商標均為其各自所有人之財產。

圖片可能與實品有所出入
[PSN1012865453TWZH](#), November, 2021.

**Hewlett Packard
Enterprise**